

Il Consorzio Hybrid Memory Cube Consortium continua a guidare l'adozione a livello industriale dell'HMC con l'annuncio delle specifiche della seconda generazione

Annuncio della versione preliminare del Gen2

SAN JOSE, California e BOISE, Idaho, 18 febbraio 2014 (GLOBE NEWSWIRE) – Il Consorzio Hybrid Memory Cube Consortium (HMCC), dedicato allo sviluppo ed alla creazione delle specifiche industriali standard dell'interfaccia per la tecnologia Hybrid Memory Cube (HMC), ha oggi annunciato il suo impegno continuo per costruire l'ecosistema HMC e supportare l'adozione di questa tecnologia innovativa attraverso lo sviluppo di una nuova specifica di interfaccia. Oggi, l'HMCC ha inoltre annunciato una versione preliminare relativa alla nuova specifica ad una lista crescente di primi membri del consorzio che oggi conta più di 120 membri. La nuova specifica supporta maggiori velocità di trasferimento dati che raggiungono una prestazione short-reach (SR) di 10 Gb/s, 12,5 Gb/s, 15 Gb/s e fino a 30 Gb/s. La nuova specifica trasferisce anche il modello del canale associato da SR a VSR in conformità alla nomenclatura industriale già esistente. L'ulteriore definizione del short-reach (USR) aumenta anche le prestazioni da 10 Gb/s fino a 15 Gb/s.

Il Consorzio HMCC, fondato da fornitori leader nel mercato delle memorie Micron Technology (Nasdaq: MU), Samsung Electronics e SK Hynix, ha iniziato a far circolare questa versione iniziale delle specifiche tra una vasta gamma di primi utilizzatori, con l'obiettivo di incorporare tutti i loro input e fissare la data di completamento della versione finale nel mese di maggio 2014. La specifica della prima generazione è stata completata e rilasciata al pubblico nel mese di aprile 2013; diversi sviluppatori e aziende adottanti, tra cui Altera, Xilinx e Open-Silicon, hanno già iniziato ad utilizzare a proprio vantaggio le specifiche per la progettazione di prodotti e soluzioni che incorporano la tecnologia HMC.

"Usando la specifica HMC Gen2, i progettisti possono ottenere ancora maggiori prestazioni dalla nostra architettura UltraScale FPGA", ha detto Hugh Durdan, vice presidente del gruppo portfolio & solutions marketing di Xilinx. "I nostri dispositivi UltraScale, che sono attualmente in vendita, sono stati progettati per supportare questa specifica ed offrire un minor rischio ed un tempo più breve per raggiungere il mercato per le applicazioni a banda larga".

"La specifica HMC Gen2 raddoppia la velocità di trasferimento dati dell'interfaccia, consentendo ai progettisti di sistema di ottenere più facilmente gli aumenti di prestazioni con celle di memorie da 20nm di nuova generazione, FPGA 14nm e SoC", ha dichiarato Patrick Dorsey, direttore senior del gruppo product marketing di Altera. "La nostra anticipata partenza nel consegnare le schede di valutazione e l'interoperabilità dimostrata tra i dispositivi Hybrid Memory Cube e FPGA consentono ai clienti di iniziare immediatamente la valutazione e lo sviluppo di sistemi ad alte prestazioni basate sull'HMC."

Il consorzio è una collaborazione mirata di OEM, attivatori e integratori che stanno collaborando nello sviluppo ed implementando uno standard aperto di interfaccia per l'HMC, una soluzione di memoria ad alte prestazioni sviluppata da Micron. I soci sviluppatori Micron Technology, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Altera Corporation, ARM, IBM, Microsoft Corporation, Open-Silicon, Inc., SK Hynix, Inc., e Xilinx, Inc., stanno lavorando direttamente con gli adottanti per supportare i requisiti collettivi per la creazione di nuovi mercati e l'adozione industriale dell'HMC.

L'HMC è un'innovazione industriale che utilizza l'avanzata tecnologia through-silicon-vias (TSVs) - condotti verticali che collegano elettricamente una pila di singoli chip - per combinare la logica ad alte prestazioni con "die" di memoria dinamica ad accesso casuale (DRAM). La prima implementazione commerciale dell'HMC di Micron è in fase di campionamento con una densità di 2 GB e con un'inedita larghezza di banda di memoria di 160 GB/s, che utilizza fino al 70 per cento in meno di energia per ogni bit rispetto alle tecnologie esistenti, abbassando drasticamente il costo totale di proprietà per i clienti.

Aziende leader nel settore e opinionisti hanno riconosciuto l'HMC come la risposta tanto attesa al crescente divario tra il rapporto fra il miglioramento delle prestazioni della DRAM ed il livello di consumo del trattamento dei dati. Le capacità dell'HMC rappresentano un salto oltre le attuali e a breve termine architetture di memoria in materia di prestazioni, packaging ed efficienza nel consumo di energia, offrendo un importante cambiamento rispetto all'attuale tecnologia di memoria.

Diventare un membro dell'HMCC

L'iscrizione come adottante nel consorzio HMCC è aperta a qualsiasi azienda

interessata a partecipare allo sviluppo delle specifiche HMC. Ulteriori informazioni, specifiche di supporto tecnico e altri strumenti per l'adozione della tecnologia possono essere trovate presso il sito www.hybridmemorycube.org.

Informazioni riguardanti il consorzio HMCC

Fondato da esponenti mondiali della comunità dei semiconduttori, l'Hybrid Memory Cube Consortium (HMCC) è dedicato allo sviluppo e alla creazione di uno standard di interfaccia specifico per la tecnologia Hybrid Memory Cube. I membri del Consorzio attualmente includono Altera, ARM, IBM, Micron Technology, Microsoft, Open-Silicon, Samsung, SK Hynix e Xilinx. Per saperne di più sul consorzio HMCC, visitare il sito www.hybridmemorycube.org.

CONTATTO: Mary Ellen Ynes

Zeno Group for Micron

+1.650.801.7954

maryellen.ynes@zenogroup.com

John Lucas

Samsung Electronics Co., Ltd.

+1.408.544.4363

j.lucas@ssi.samsung.com